



# 智能硬件步步惊心！ 互联网公司不得不防的**十大陷坑**

腾讯科技 2014年03月26日

【内部档案 请勿收藏 和 分享】



《战略档案》  
一份现成的  
商业情报



# 议题：硬件，每一步都是深坑

## 01 一失足，公司就死掉了

智能硬件正热，很多互联网公司和创业者选择进入这一“**前景无限**”的蓝海。但令人不安的是，脱胎于传统工业化流程的硬件领域，从设计到制造存在很多互联网公司不熟悉的环节。一个失误就可能**毁掉**一款产品，甚至一个创业公司。

## 02 我们讨论什么？

一款硬件产品诞生的**全流程**是怎样的？哪些环节需要互联网公司格外留神？如何尽量降低硬件产品研发的**失败风险**？互联网公司做硬件，交学费几乎是必然。这份档案不能保证你安全无恙，但可以让你的学费尽量交的少一些。





# 流程：一款硬件产品的诞生

- 以手机产品为例，从市场调研、产品立项，到最后上市、发货，需要经过诸多环节“打磨”。下图中**绿色**为互联网公司**熟悉**(或部分熟悉)的领域，**橙色**为互联网公司不熟悉的**陌生领域**。





# 思维：互联网并不万能

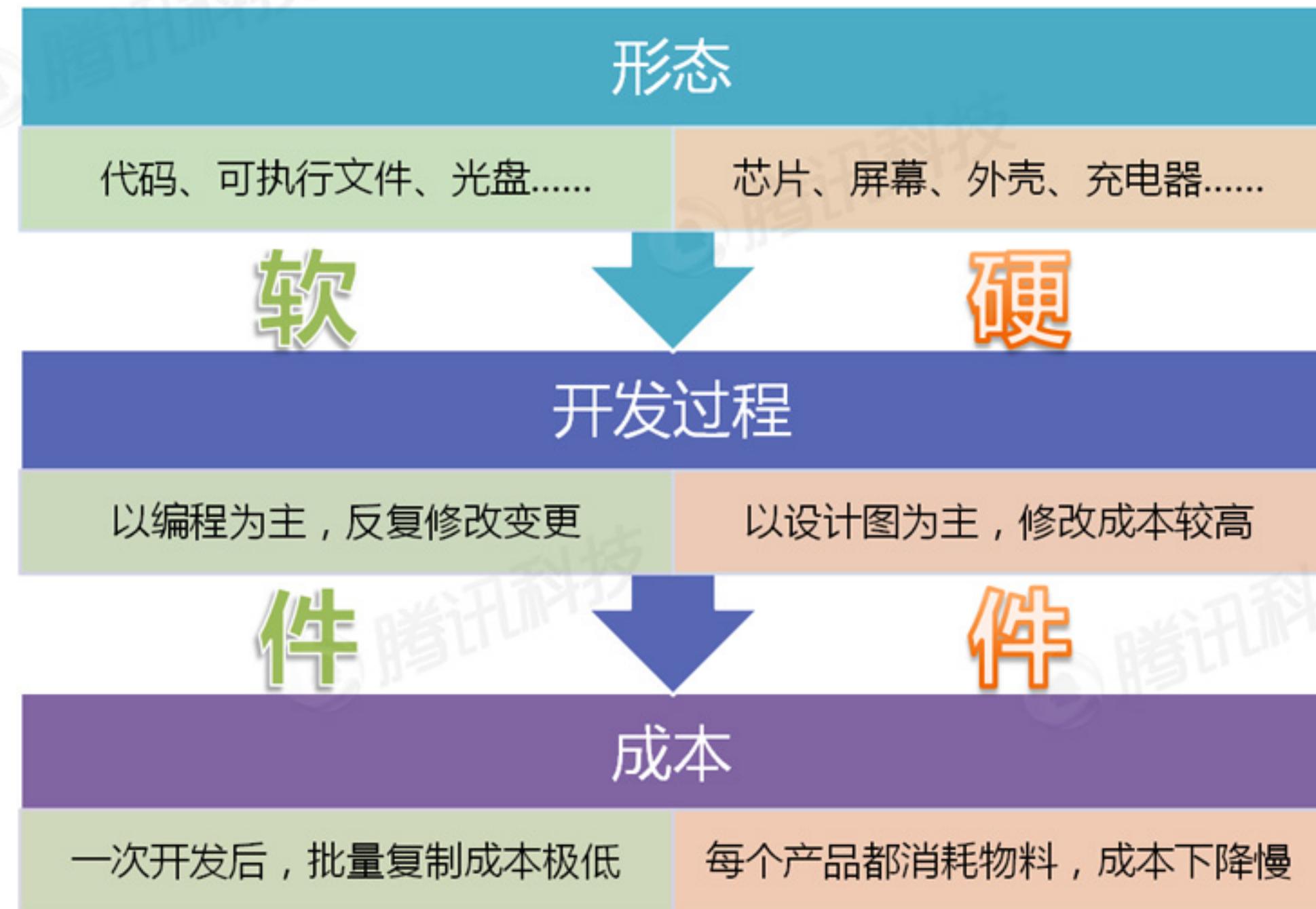
- 毋庸置疑，互联网公司进入硬件领域，带给传统硬件厂商的**压力**是巨大的——但若要全面颠覆，还为时尚早。在上一页的流程图中，每一个**橙色部分**，都是**挑战**。





# 差异：硬件到底是什么

- 软件和硬件在形态上的差别就像**动物**和**植物**一样显而易见。但当我们需要从内在**逻辑**上，科学分辨它们之间不同的时候，却常常感到模糊。





# 一号坑：需求胡乱承诺

谁满足了用户需求，谁就赢得战争——类似这样的**金句**在互联网领域颇为流行。但和拥有较大弹性的软件开发不同，硬件的实现条件受**物理条件**所限，更为苛刻。

## 超前需求

- 目前硬件条件无法实现，必须放弃

## 过度需求

- 与产品定位不符，冷静一下

## 模糊需求

- 无法细化到参数层次，造成采购浪费

## 风险遗留

- “加加班能实现吧？”这种想法会害死你

回忆一下那些概念图无比美丽，但产品不断“跳票”的故事，每一个都是眼泪……



# 二号坑：轻视硬件设计

- 软件开发出现设计偏差，后续纠正的成本并不太高。但硬件的**容错空间**极小，从一开始就要避免失误。多找牛人，反复论证，**磨刀**不误砍柴工。

PCB(印刷电路板)设计  
不全面，导致“飞线”

线路某处间距过窄，  
导致性能不稳定

设计的灾难

天线设计不合理，影  
响信号性能

芯片布局失误，导致  
性能受其他模块影响

还记得iPhone 4的  
“天线门”么？连  
乔布斯治下的苹果，  
都会犯错误。



# 三号坑：零件采购随意

硬件产品开发需要采购多种零件，从核心的**处理器芯片**到**一颗螺丝**，都有犯错误的可能。一个优秀的供应链管理专家清楚这里面的**各种门道**——每一个都涉及产品的生死存亡。

- 核心部件只选了一家供货商，一旦对方毁约，产品进度遭遇重大打击
- 冒然“吃螃蟹”，选择未经市场验证的零件，导致产品进度延迟。甚至开发失败
- 选择有多家竞争的热销零件，供货商很可能优先供给老客户或大客户。
- 缺乏前瞻性，硬件更新换代太快，若采购的零件在产品开发过程中过时，就会降低产品竞争力

**三星曾断供OLED屏幕组件，导致HTC不得不中途更换供货商。**





# 四号坑：结构失之毫厘

- 硬件的结构设计看起来很简单，不过就是几个外壳的**尺寸规格**。但这里又是初学者甚至老玩家都最容易犯错的地方，游标卡尺上**0.01**的偏差，都可能导致产品**变形**，甚至无法组装。

一处凹凸：手机外壳磨具上的一处不起眼的凹凸不平，导致手机散热严重受限

一道缝隙：不同壳组之间极为细小的尺寸误差，让组装后的产品无法严丝合缝

一阵颤抖：超薄新产品忽略了内部空间布局，导致手机震动模块“无处安放”

诺基亚、小米都曾出现过手机电池“晃动”的设计偏差，导致用户不满。垫个纸片可以解决问题——误差就是一张纸的厚度。



# 五号坑：软硬件无法“在一起”

- 很多项目“晕倒”在软件与硬件的适配环节上。软件可能只发挥了硬件**70%**的潜能，或者硬件根本无法满足软件**流畅运行**的全部条件。



某厂商硬件部门为降成本更换了芯片供应商，因为规格一致所以没有通知软件团队。

到适配阶段，发现软件根本无法驱动。



# 六号坑：试制开始败家

- 产品正式量产前，需要进行小批量试制，为**产品整机**做全面测试和检验。一些项目按照软件的经验推进，发现一个问题就**更新**一次版本，导致试制不断滚动，败家无数。



有公司内部创业团队迫于竞争压力，在产品未稳定时盲目启动试制，结果产品多次修改，浪费大量时间和资金，最终项目失败。



# 七号坑：物料成本失控



软件开发对成本很少精打细算，因为软件一旦批量上市，一次性研发支出将被逐渐**摊薄**。但在硬件领域，不同物料成本在大规模生产中的降幅并不相同，而且会很快触及**成本底线**。

未来降幅有限

采购成本溢出

占成本大头的核心零件涨价

工艺改进导致成本上升

部分零部件不在早期成本清单中

批量生产无法明显降低硬件投入

过多囤积物料存在库存风险

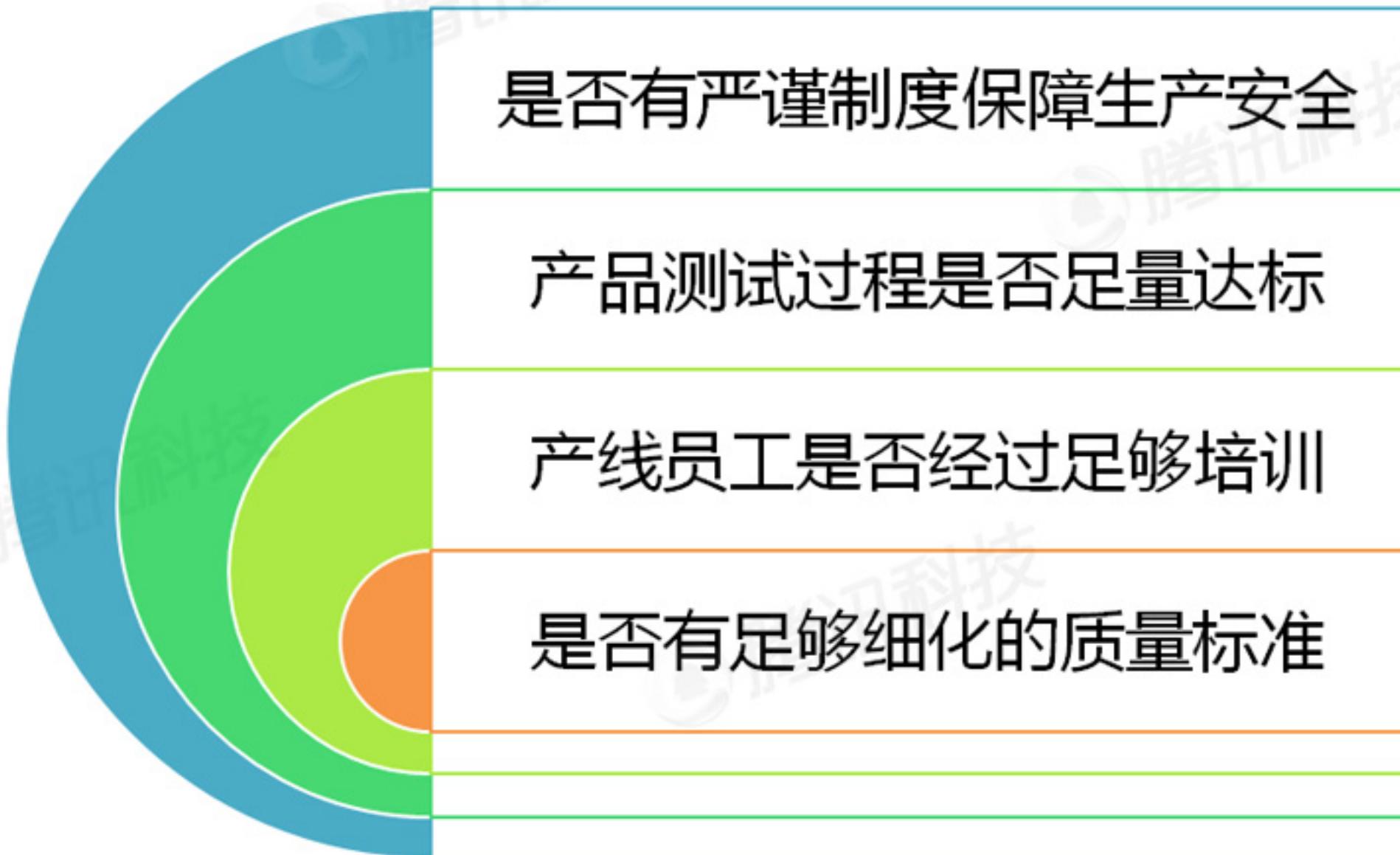
某厂商接受运营商10K订单，每部100美元。

但由于成本管理不精细，加上中途更换零件，导致成本超订价，最终亏损。



# 八号坑：制造偷工减料

- 如果没有安排专业、明眼的“自己人”**进驻**代工厂，产品的制造加工**质量**就难以得到保证。一些肉眼看不见的差别，会在产品到达用户手中数月后，产生严重后果。



曾有代工厂在订单爆棚期间，将部分产品的老化测试时间减半，甚至取消。这直接导致产品稳定性存在隐患，增加售后风险。



# 九号坑：产能不足的秘密

- 产品不断延期，**上市即缺货**的情况，在硬件领域经常发生，特别是初创公司。实际上，刨除部分公司的**营销假象**，真正的产能不足，可能由多种因素造成。



有时候，加工厂说  
这批货需要一个月  
完成，但实际上，  
他们可能拖到最后  
一周才开始——  
订单越小，被拖后  
的可能越大。



# 十号坑：包装与配件添乱

- 互联网领域的“包装”通常是虚拟的，硬件的包装却是实实在在的**盒子、箱子、袋子**。别以为把产品包装设计漂亮就大功告成了，你需要用“**硬件思维**”来想问题，才能考虑周全。

包装强度  
是否满足  
长途运输？

各语种说  
明书是否  
配套？

运输提示  
和标识是  
否完整？

充电、射  
频等标准  
是否符合？

曾有厂商为彰显国  
际范，特别在内  
市场的產品中加入  
英文版说明书——

可惜翻译不过关，  
里面全是语法错误。



# 了解了这些坑，我们该怎么做？

## 杀掉 你的乐观

一家刚刚进入硬件领域的互联网公司，无论你把难度和风险放到多么重视的程度，最终你都会发现，你还是**低估了**这个行业。

千万别**太乐观**。对于不熟悉领域，越自信的人下场越惨。





# 了解了这些坑，我们该怎么做？

## 踏实点 别吹牛

软件需求偶尔带有**期望性**附加值，即“我希望可以实现”。但在硬件领域，需求必须是严谨且可行的。

不要给自己留幻想，**盲目的承诺**会毁掉整个项目。

### 软件

超前承诺，后续逐渐实现

人月神话，一切难题都可以加班搞定

需求变更，修改几行代码

### 硬件

只考虑现实性，别考虑可能性

物理限制，累死也无法超越客观条件

需求变更，一套物料就废了



# 了解了这些坑，我们该怎么做？

# 方案 细到毫米

硬件的方案设计，最忌讳存在**模糊地带**。物料清单是否完善，尺寸规格是否精确，直接影响产品成败。

尽量把**准备工作**做到位。因为后续每一次修改都代价巨大。

## 硬件

- 考虑到各种情况和元器件之间的影响。布局合理，特别是射频和散热

## 结构

- 所有的尺寸单位统一。同时，精确，精确，再精确

## 物料

- 别漏掉任何细节，别省略任何参数。即使外行拿着你的清单，也能买到正确东西

## 时间

- 给每个环节留有足够的验证时间。硬件研发需要步步为营，别带着问题进入下一关

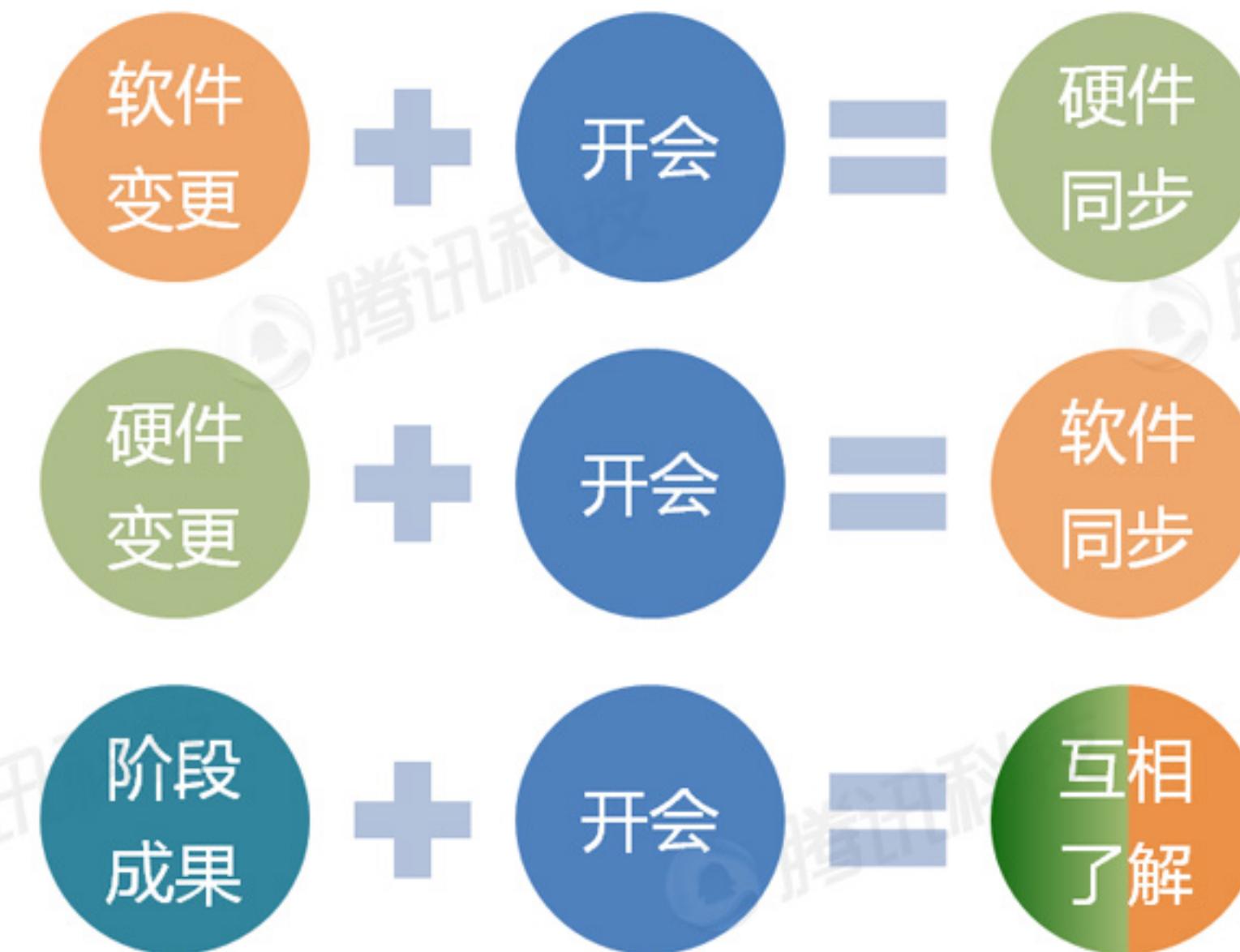


# 了解了这些坑，我们该怎么做？

# 开会 必须频繁

千万不要让软件与硬件各忙各的，到最后才发现，双方产品无法“**组合**”到一起。

在研发过程中，软硬件部门间要建立周期性沟通**例会制度**，把分歧和误差，消灭在萌芽状态。



涨姿势  
扫我

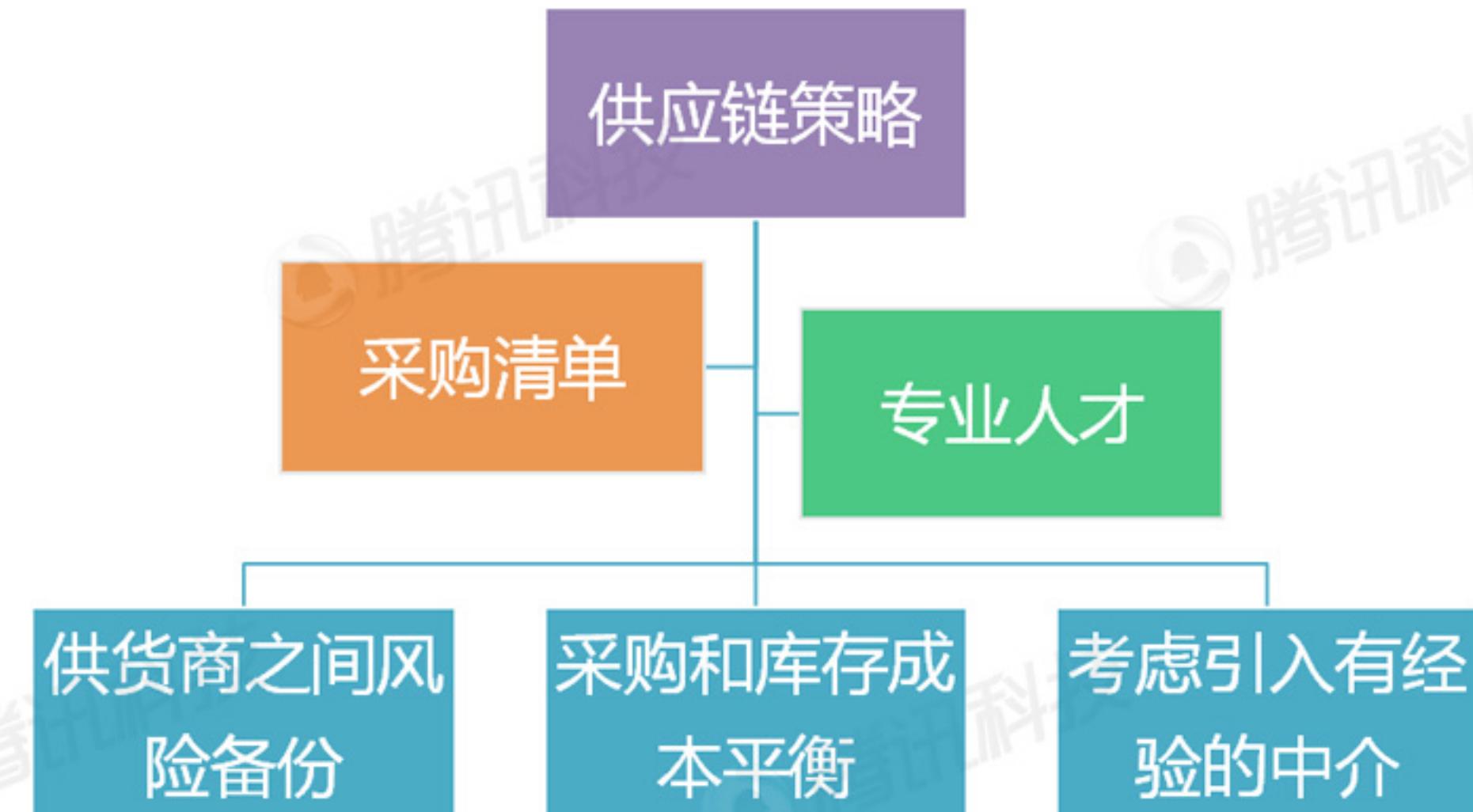


# 了解了这些坑，我们该怎么做？

## 采购 不是买卖

物料和零件采购不仅是拿着清单**买东西**这么简单。一个做硬件的企业，必须有自己的供应链管理体系、人才和策略。

硬件领域有一句谚语：得**供应链者**，得天下。



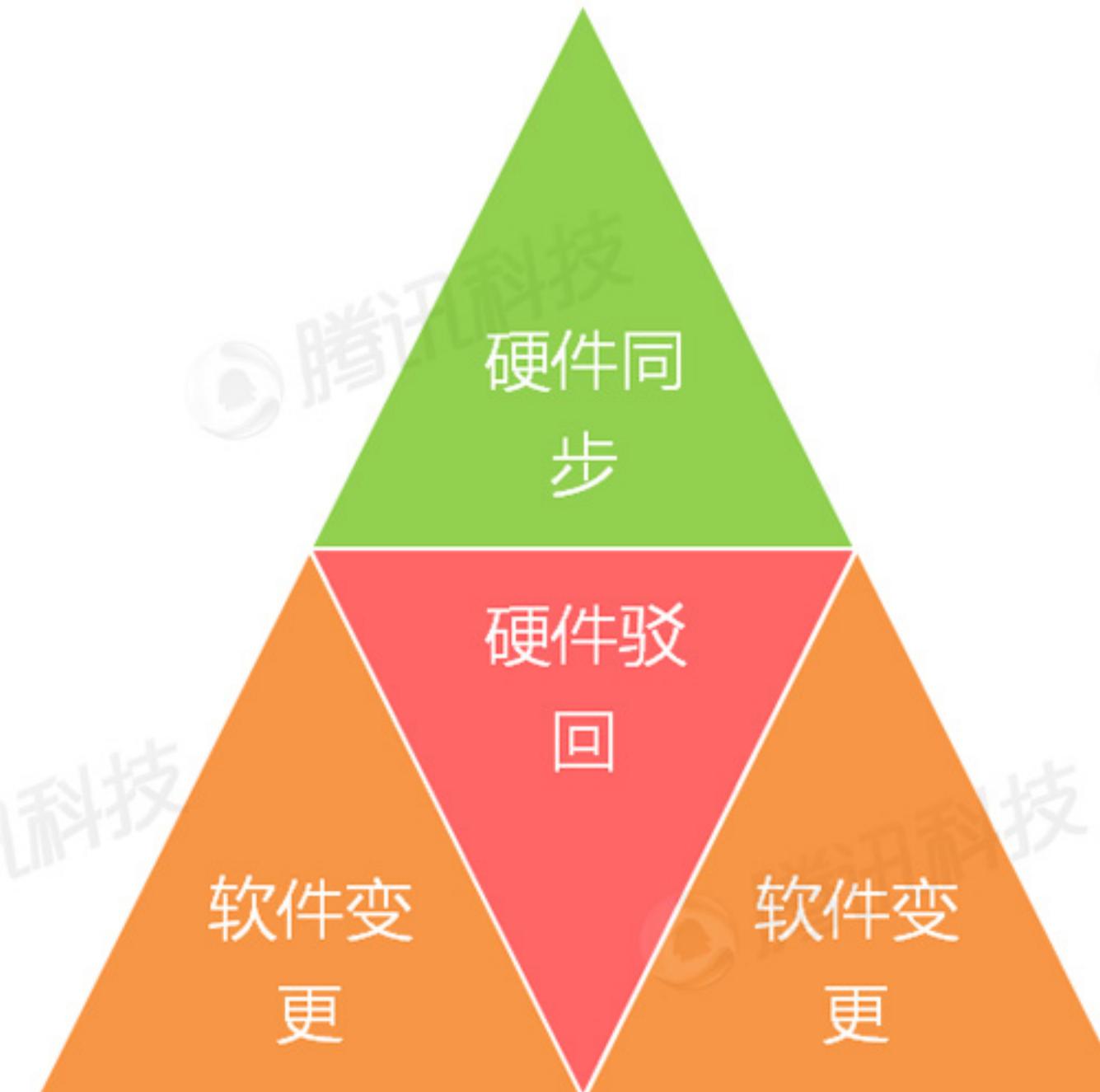


# 了解了这些坑，我们该怎么做？

## 确立 谁是老大

在硬件和软件之间，必须确定**主次关系**。产品是一个整体，软件或硬件的变更，都会直接影响另一方的设计和进度。

通常来说，**硬件更重要**。因为硬件修改成本太高，容错空间很小。



涨姿势  
扫我



# 了解了这些坑，我们该怎么做？

## 严控 硬件版本

硬件开发越到后期，版本变更带来的**成本损耗**越大。和软件的每日迭代不同，硬件应严格控制版本变更频率。

别到最后正式产品还没上市，  
**工程机**已经堆满了库房。

计划外版本  
只生产少量

做好硬件  
版本规划

每次试制要  
有重要变更

严格执行  
版本迭代



涨姿势  
扫我



# 了解了这些坑，我们该怎么做？

工厂

## 全是细节

制造环节对互联网公司是最陌生的。尽量选有能力的**大厂**，并说服对方优先考虑你的产品生产计划。

这个行业对“新人”总是不够信任。试着展示你的**美好前景**和未来，争取合作机会。

尽量精确的产能排期

提前做好物料采购准备

提供完整的加工清单

敦促工厂做好加工培训

安排专业人土驻厂跟踪

确保软硬件足够成熟

产品细节要求不能降低

尽量避开制  
造高峰期





# 了解了这些坑，我们该怎么做？

## 包装 可以讨巧

包装盒，说明书，充电器，数据线……这些看似**边缘**的配件，往往是细节最佳的试验场。

用户对硬件产品的第一印象，就是包装。花点心思在上面，往往可以又省钱，又出效果。

简洁

- 让包装设计更清爽些，减掉繁琐元素，保留核心价值传递

白色

- 内外部包装和配件尽量选用浅色调，以白色为佳

卡片

- 抛弃厚厚的说明书吧，没人愿意看。采用卡片设计，轻巧省钱

捆线

- 让数据线的捆绑更漂亮些，捆线若可重复使用更佳。包装袋别用撕开设计，太粗暴

涨姿势  
扫我



# 了解了这些坑，我们该怎么做？

## 别信 成功传说

一个榜样可能会带动一批热血青年，硬件领域也不例外。看到一些成功项目后，常常觉得自己也可以放手一搏。

但成功的故事通常是感性的，**难以复制**。多看些失败者的教训，然后，小心前行。

越过每一个坑，才可能**成功**

失败 失败 失败 失败





《战略档案》官方微信，扫描左侧  
二维码或搜索微信公众号 “**biznext**”  
从这里解悟科技背后的商业逻辑。

监制：龙兵华 靳志辉  
策划：王 冠  
设计：于春慧

战略档案顾问群和粉丝群长期开放，  
有兴趣的同学请在关注微信公众号后，  
回复 “**rh**” 获取详细 “入伙” 攻略！

【内部档案 请勿收藏 和分享 】

